

# 易華電子股份有限公司



股票代號：6552

2024/04/23

本簡報中對產業未來的展望為反映本公司截至目前為止的看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



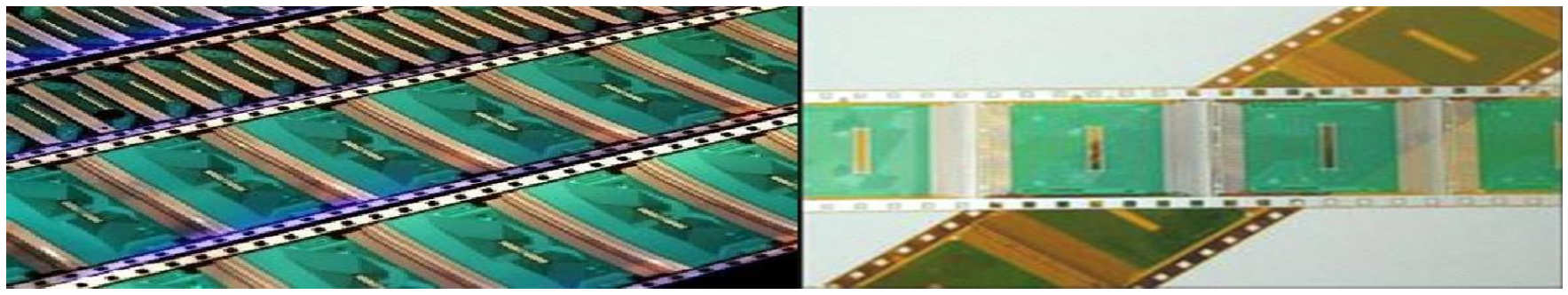
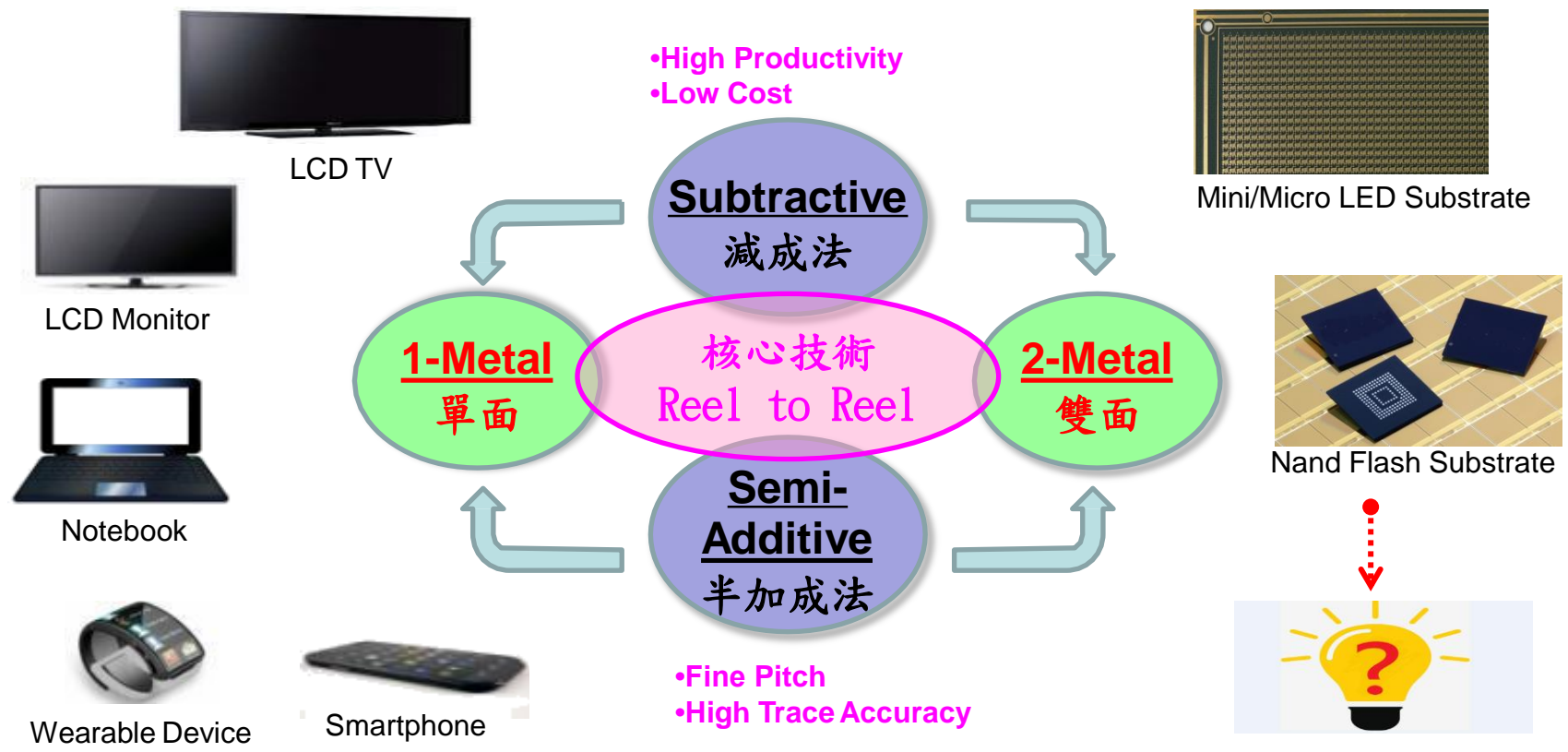
*-Professional Reel-to-Reel Fine-Pitch Service*

# 一、公司概况-基本資料

- 公司設立：1973年10月6日(原名台灣住礦電子股份有限公司)
- 董事長：萬文財
- 總經理：李宛霞
- 實收資本：新台幣8.3億元
- 主要股東：長華42.8%、南茂10%
- 員工人數：622人(截至2023年12月底)
- 主要產品：捲帶式高階覆晶薄膜IC基板(Reel to Reel Chip on Film)
- 地址：高雄市楠梓區新開發路8號



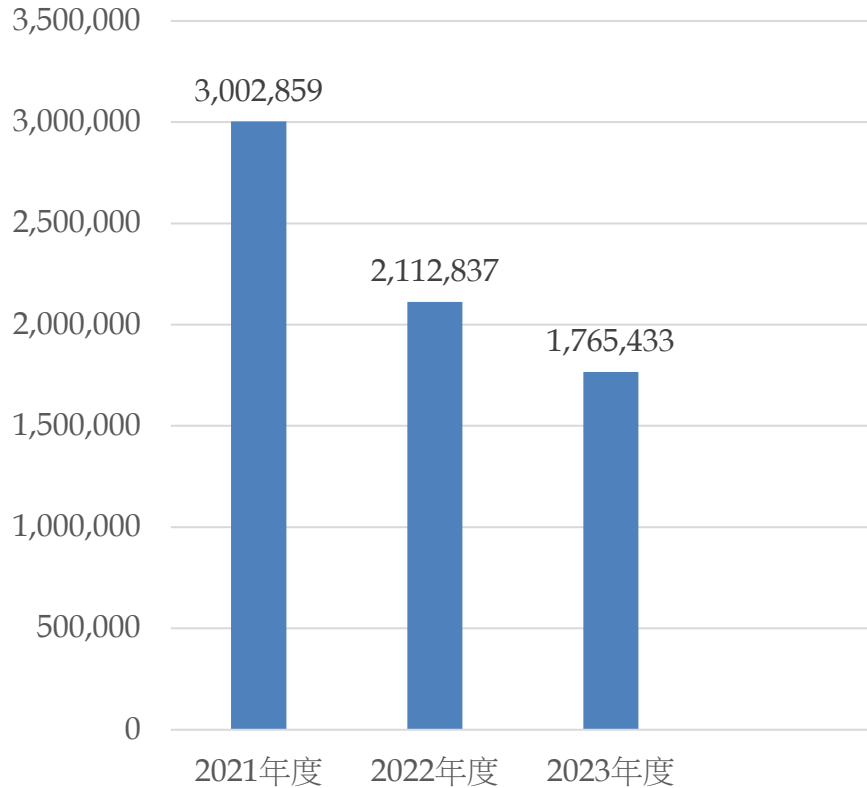
# 一、公司概況-產品應用



## 二、營運績效-歷年營收及獲利

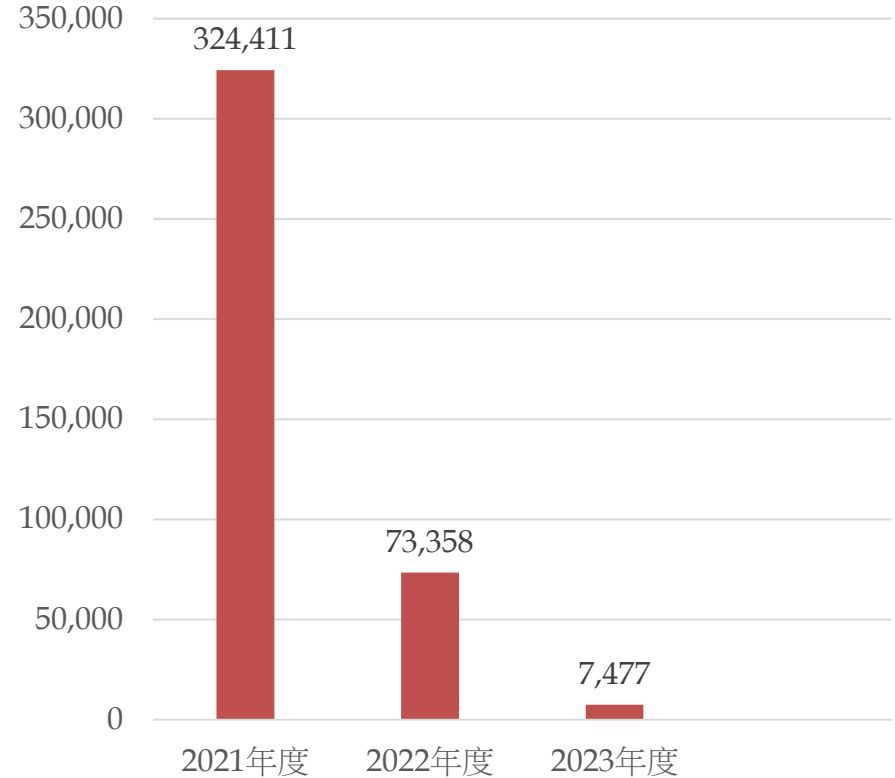
### 營業收入

單位：千元



### 稅後純益

單位：千元

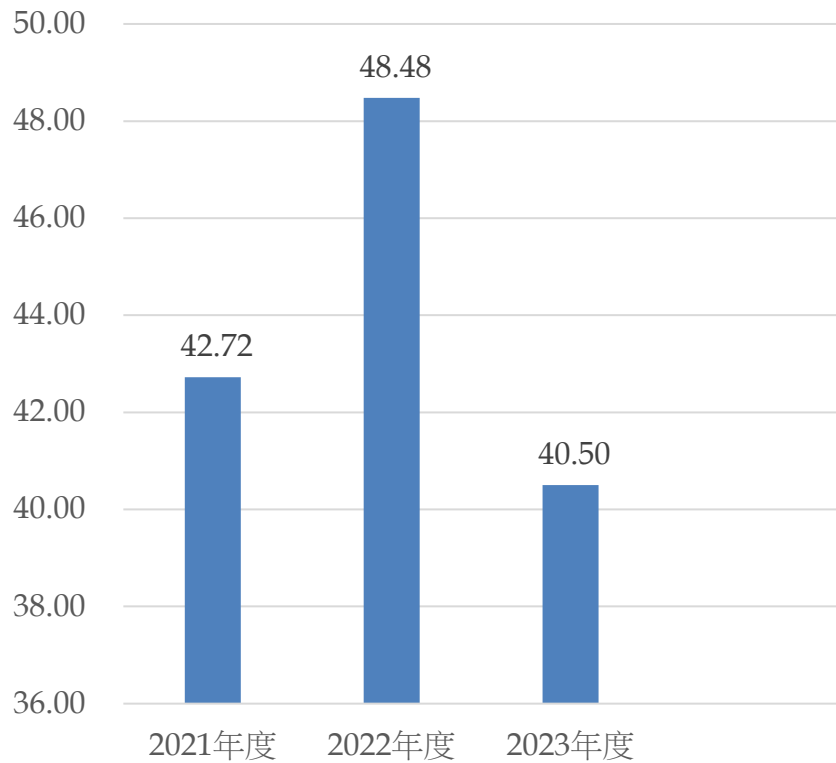


單位：新台幣千元

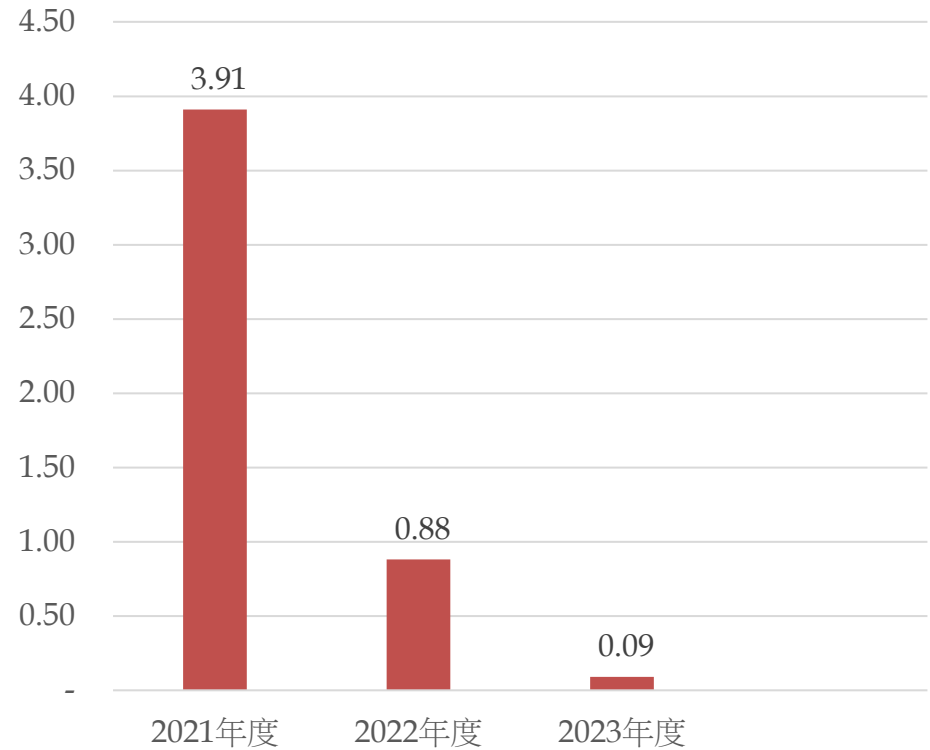
年度	2021年度	2022年度	2023年度
營業收入	3,002,859	2,112,837	1,765,433
稅後淨利	324,411	73,358	7,477

## 二、營運績效-財務比率分析

負債比率



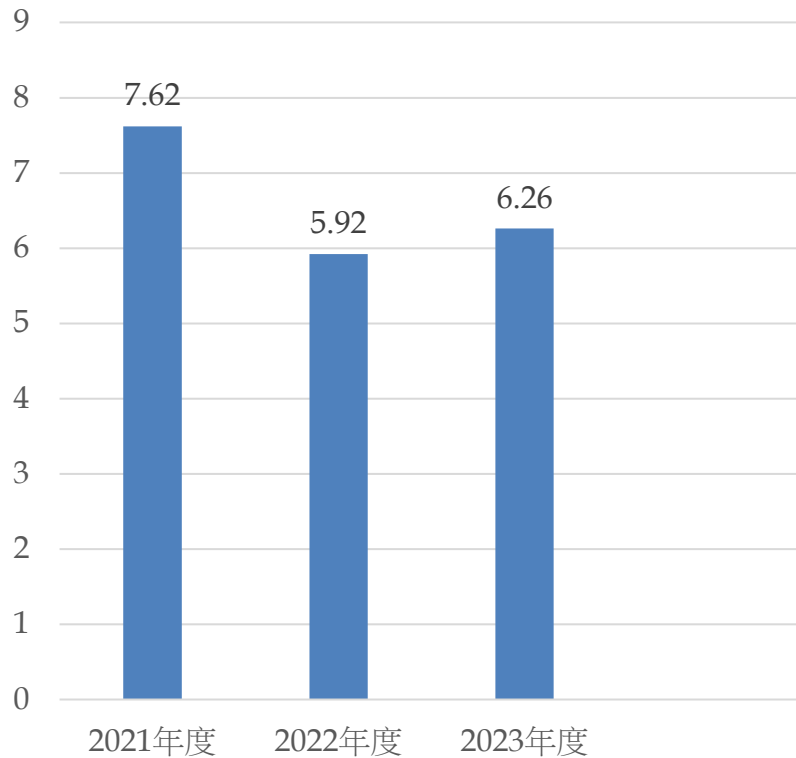
每股盈餘(元)



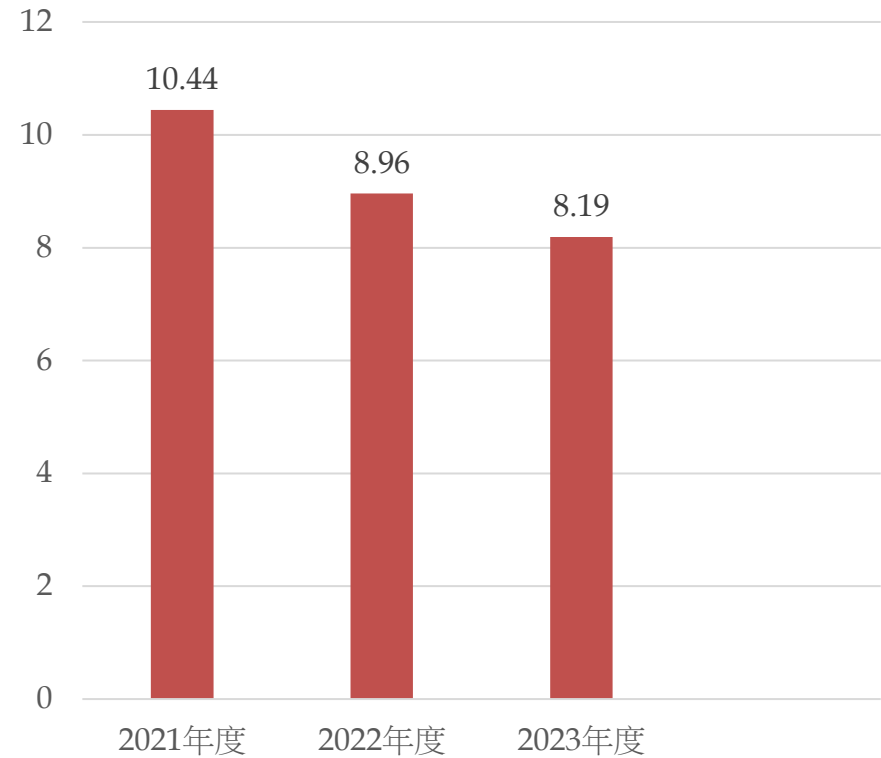
年度	2021年度	2022年度	2023年度
負債比率	42.72	48.48	40.5
每股盈餘(元)	3.91	0.88	0.09

## 二、營運績效-財務比率分析

應收款項週轉率



存貨週轉率



年度	2021年度	2022年度	2023年度
應收帳款週轉率	7.62	5.92	6.26
存貨週轉率	10.44	8.96	8.19

# 三、市場狀況與業務展望-1 Metal COF for 大尺寸面板

## ✓ 目前：戰爭、通貨膨脹、經濟成長停滯，影響全球民生需求

\*全球經濟成長預測持續下修。

\*戰爭及地緣性衝突持續不斷增加，造成電子產品終端應用市場雜音不斷。

\* TV面板及IT面板產值在2020及2021年大幅成長，尤其在2021年，高達3~4成之成長率。但自2022年起，高成長之市場需求下滑，2023年面板廠持續減產及去化庫存。

\*預計2024年面板市場有機會回到傳統需求模式，2025年間回歸為穩定需求市場。

## ✓ 未來：新設計、新應用…，趨勢不變；需求時間遞延

\* TV面板 – 4K -> 8K趨勢已然呈現，靜待市場需求。

\* Monitor/NB/Tablet面板 – 開始出現無邊框應用；由COG轉為COF的設計。

\* 車用面板 – 開始COF的設計。

### 三、市場狀況與業務展望 - 1 Metal COF for小尺寸面板

#### ✓ 目前：手持式裝置用驅動IC設計趨勢更迭

- \*手機面板用驅動IC晶片，COP設計增加，因此COF使用量持續降低。
- \*手錶手環兼具健康管理功能成為顯學，COF在此領域用量需求穩定成長。

#### ✓ 未來：新設計、新應用…，趨勢不變

- \*高階手機用軟性OLED – COP 增加，1-Metal COF減少
- \*中階手機用硬屏OLED/LTPS – FHD TDDI/FTDDI用1-Metal COF，部分用COG。
- \*低階手機用面板 – 使用COG。
- \*Wearable面板-穿戴裝置面板由於邊框要求，陸續由COG轉為1-Metal COF設計，市場需求穩定成長。



## 三、市場狀況與業務展望 - 2 Metal Substrate

### ✓ 目前：LED直顯和背光市場並進，應用開枝散葉

- \* 2021年堪稱Mini LED相關產品增量的一年，加速2022年下世代顯示技術發展。於2022年初CES展會上，各品牌廠積極發表新型顯示器，其中不乏Micro LED相關產品，足見廠商重視先進顯示產品市場發展。
- \* 2023年Mini/Micro LED的開發與應用積極活絡。
- \* 預期2024年易華的2 Metal Substrate，有機會開始應用於Micro LED產品。

### ✓ 未來：新設計、新應用...

- \* 易華 **2-Metal 技術** 除了Mini/Micro LED Substrate的開發應用外，亦將拓展其他IC Substrate的領域。

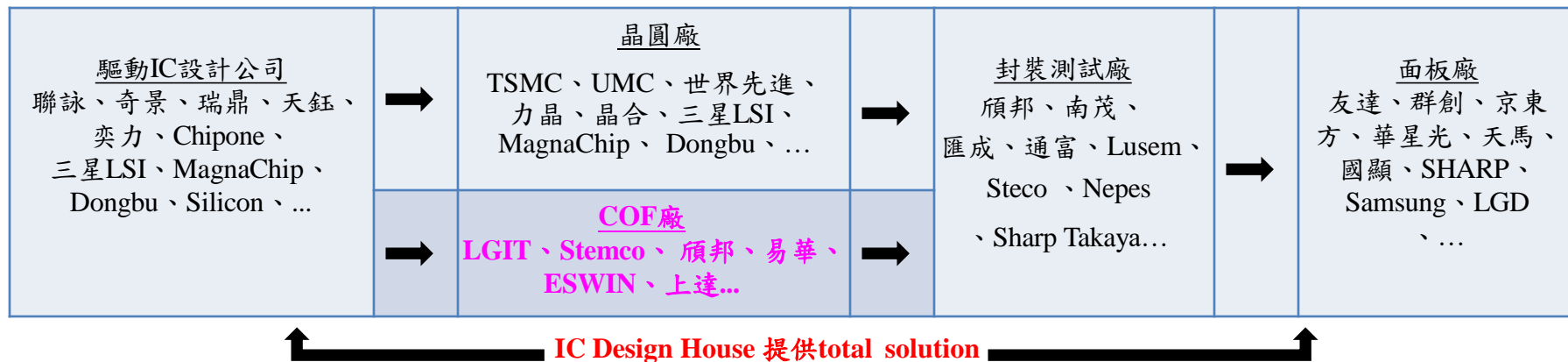
# 三、市場狀況與業務展望 - 技術與產品開發

## ✓ 提供客戶全方位軟性IC Substrate產品之供應商

製程	競爭優勢	技術/應用	目標產品/新產品
1-Metal Sub 減成法	<ul style="list-style-type: none"> <li>*生產速度快，效率高。</li> <li>*技術能力自主，生產良率穩定。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*銅厚#~8um</li> <li>*線路<math>\geq</math>20um Pitch</li> <li>*腳數<math>\leq</math>1440 Channel/48mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>@ LCD TV</li> <li>@ OLED TV</li> <li>@ <b>Dual Cell LCD</b></li> </ul>
1-Metal Semi 半加成法	<ul style="list-style-type: none"> <li>*高精度尺寸控制的COF產品，可以提升面板模組組裝良率；協助客戶降低Total Cost。</li> <li>*生產良率高及品質穩定性佳，在生產成本上具有絕對的競爭優勢。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*銅厚#~12um</li> <li>*線路<math>\geq</math>18/16/14um Pitch</li> <li>*腳數<math>\leq</math>1900 Channel/48mm <math>\leq</math>3000 Channel/70mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>@ 智慧手機</li> <li>@ 穿戴裝置</li> <li>@ <b>FoD</b></li> <li>@ <b>FTDDI</b></li> </ul>
2-Metal 雙面法	<ul style="list-style-type: none"> <li>*新製程技術開發能力。</li> <li>*具備設備設計能力。</li> <li>*成本控制能力佳。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Thin Film IC Substrate</li> <li>*LED IC Substrate</li> <li>*腳數<math>\leq</math>2500 Channel/48mm <math>\leq</math>4000 Channel/70mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>@ LCD</li> <li>@ <b>Mini LED</b></li> <li>@ <b>Micro LED</b></li> <li>@ <b>IC Substrate</b></li> </ul>

# 四、產業概況-驅動IC供應鏈

## ✓ IC Design House提供total solution



## ✓ COF廠分佈區域

製程技術		1-Metal(單面)減成法 Subtractive(Etching)	1-Metal(單面)半加成法 Semi-Additive(Plating)	2-Metal(雙面)	
應用	腳數(Channel)/帶寬	=<1400 /48mm	1400~1900 /48mm	1900~2500 /48mm	
		=<2000 /70mm	2000~3000 /70mm	3000~4000 /70mm	
產能	韓國	S社	90~100KK	?KK(2-Metal改1-Metal)	7-10KK
		L社	120~130KK	?KK(2-Metal改1-Metal)	5-7KK
	日本	F社	20KK	X	2KK
	台灣	C社	70~90KK	X	X
		易華	40KK	40KK	5KK
大陸	ESWIN 上達	? ?	? ?	? ?	

# Q&A

